

2-1-1-4 SR かすれ／SR 的漏印／Solder resist blur

【特徴】SR が、広い範囲でかすれている状態の欠陥

【特征】漏印 SR 的面积大的缺陷。

【Characteristics】Solder resist is widely blurred.

【原因・判断ポイント・発生工程】SR インク粘度不適や、印圧調整不適、インク供給不足などで出来たもの（SR 印刷工程）

【原因、判断要点、发生工序】SR 油墨的粘度不合适、印刷压力不合适、油墨供给不足等所造成的（SR 印刷工序）。

【Causes/processes involved/keys to judgment】This defect is caused by use of improper solder resist viscosity and improper printing pressure, and insufficient ink feed (Solder resist application)



【コメント】顕微鏡倍率×5

【注釋】显微镜倍率×5

【Comments】Magnification: ×5



【コメント】端子と端子の間へのSRの埋まりがかすれている
顕微鏡倍率×10

【注釋】插脚与插脚之间漏印SR
显微镜倍率×10

【Comments】Solder resist blurs between pads resulting in insufficient filling.
Magnification: ×10

2-1-1-5 SR にじみ／SR 的渗出／Solder resist (spread) ooze

【特徴】SR の溶剤が、SR パターンの淵から染み出している状態の欠陥

【特征】SR 的溶剂从 SR 图形边缘渗出的缺陷。

【Characteristics】Solder resist solvent oozes out of the edge of a solder resist pattern.

【原因・判断ポイント・発生工程】SR インク粘度不適や、印刷環境温湿度などが不適切な為に出来たもの（SR 印刷工程）

【原因、判断要点、发生工序】SR 油墨的粘度不合适、或者印刷环境的温湿度不合适所引起的（SR 印刷工序）。

【Causes/processes involved/keys to judgment】This defect is caused by use of improper solder resist viscosity, improper temperature and humidity in printing environment (Solder resist application)



【コメント】端子と端子の間へのSRの埋まりがかすれている
顕微鏡倍率×10

【注釋】插脚与插脚之间漏印SR
显微镜倍率×10

【Comments】Solder resist blurs between pads resulting in insufficient filling.
Magnification: ×10



【コメント】顕微鏡倍率×5

【注釋】显微镜倍率×5

【Comments】Magnification: ×5